



(19) 中華民國智慧財產局

(12) 設計說明書公告本

(11) 證書號數：TW D232416 S

(45) 公告日：中華民國 113 (2024) 年 07 月 21 日

(21) 申請案號：112303654

(22) 申請日：中華民國 112 (2023) 年 07 月 21 日

(51) LOC.(13)Cl.：15-99

(30) 優先權：2023/02/15 日本

2023-002895

(71) 申請人：日商國際電氣股份有限公司 (日本) KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION (JP)
日本

(72) 設計人：保井毅 YASUI, TAKESHI (JP)；油谷幸則 ABURATANI, YUKINORI (JP)

(74) 代理人：林志剛

(56) 參考文獻：

JP D1230205

JP D1399758

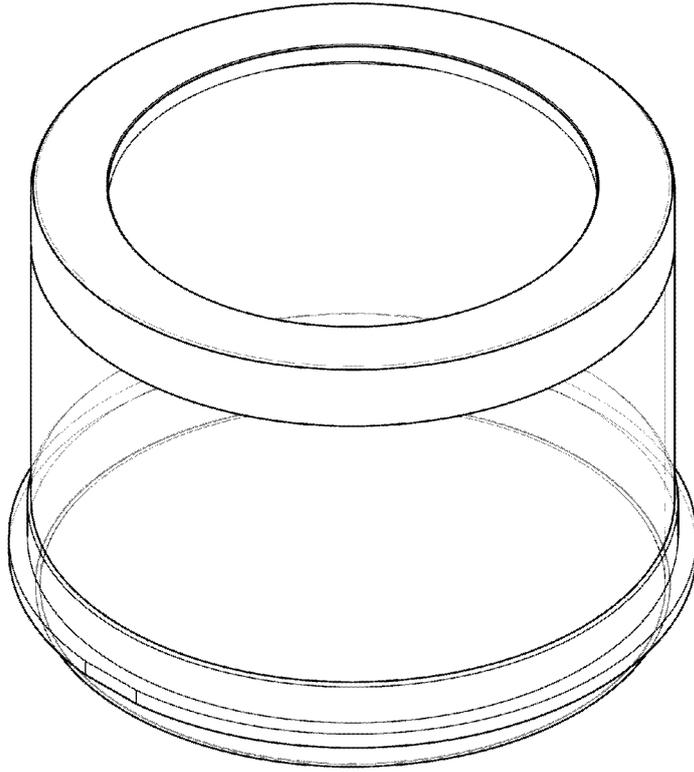
審查人員：黃少瑜

圖式數：10 共 7 頁

(54) 名稱

基板處理裝置用熱處理容器

代表圖：



【立體圖】



公告本

D232416

【設計說明書】

【中文設計名稱】 基板處理裝置用熱處理容器

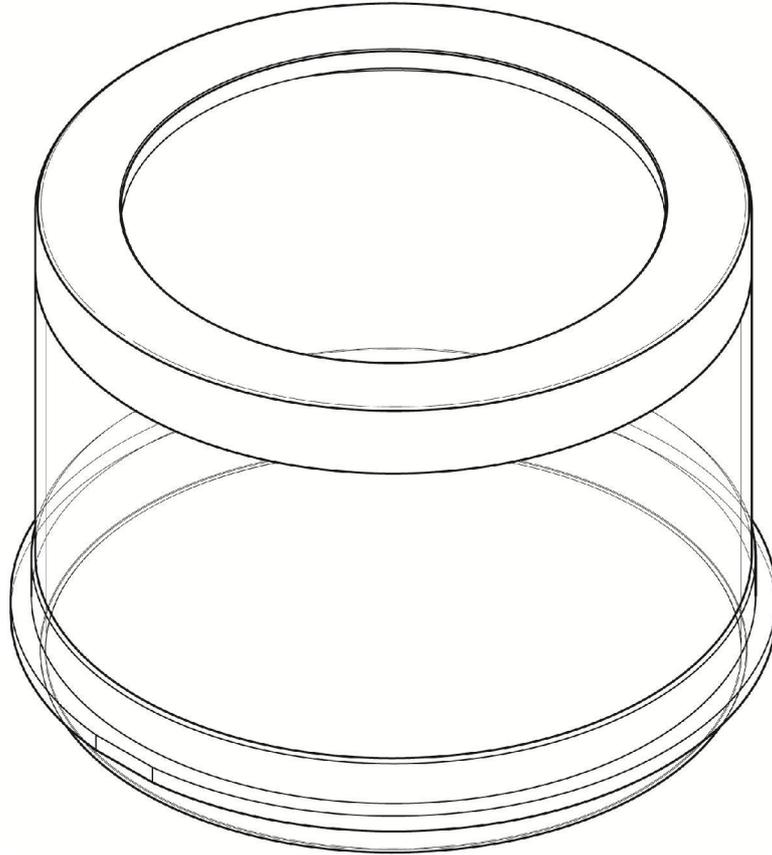
【物品用途】

【0001】 本設計的物品是基板處理裝置用熱處理容器，是在將加熱源設置在晶圓上方，且具有使來自加熱源的熱線被晶圓反射之構造的反应室內，用於防止因受到反射的熱線而導致密封部變高溫的熱處理容器。

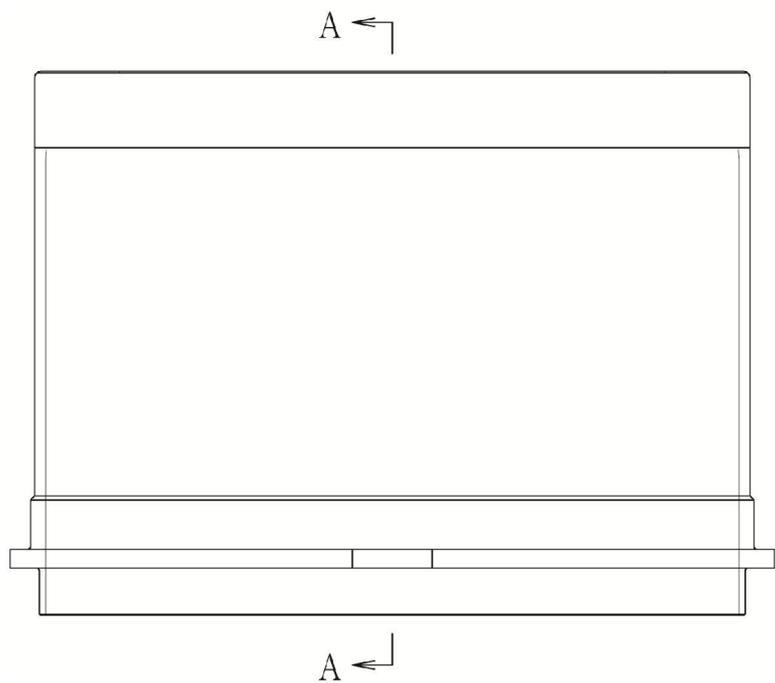
【設計說明】

【0002】 呈現在「表示透明部分參考圖」中的斜線部分是透明的。

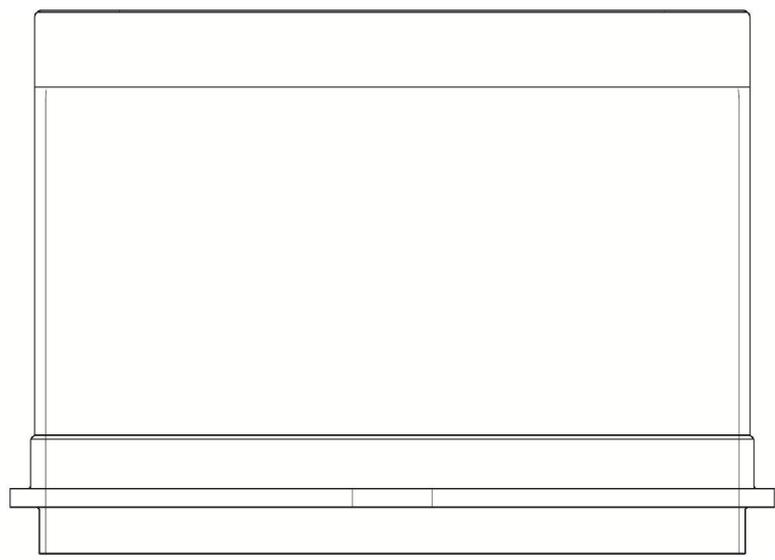
【設計圖式】
(指定代表圖)



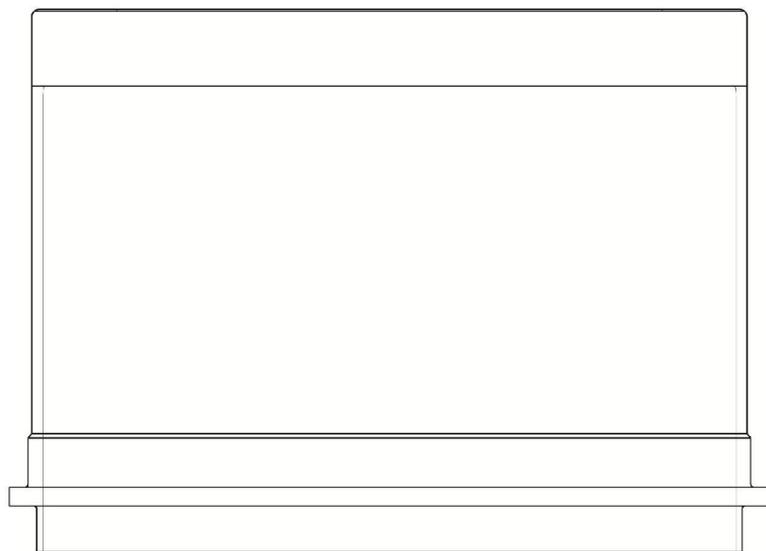
【立體圖】



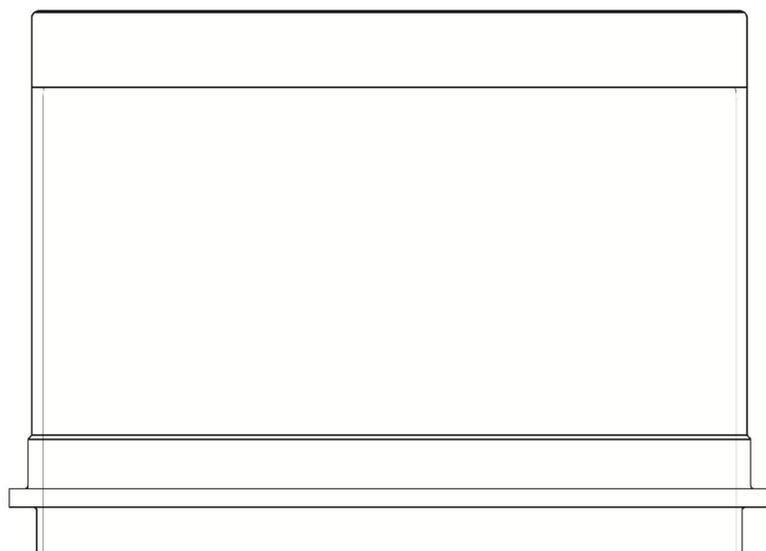
【前視圖】



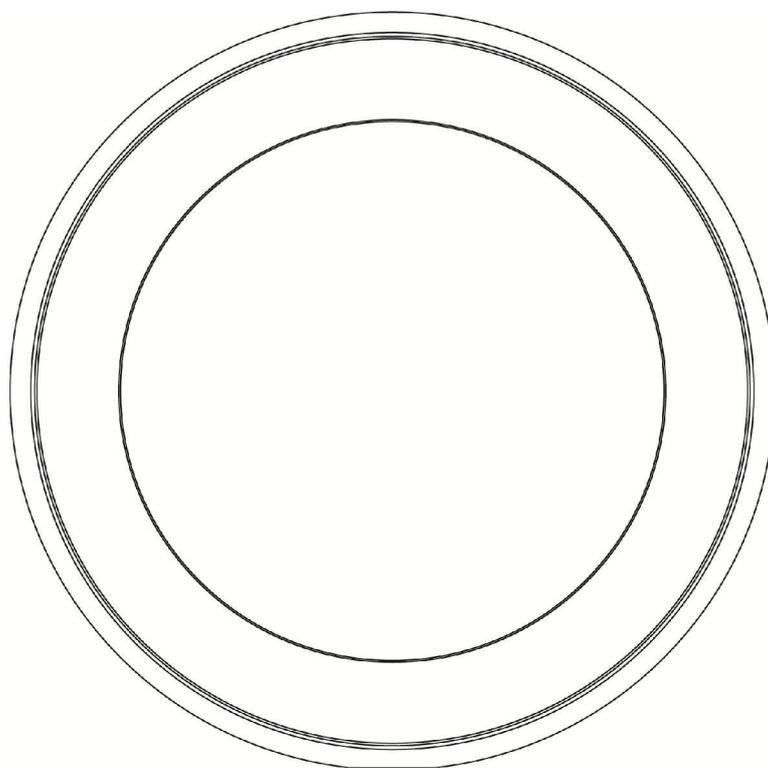
【後視圖】



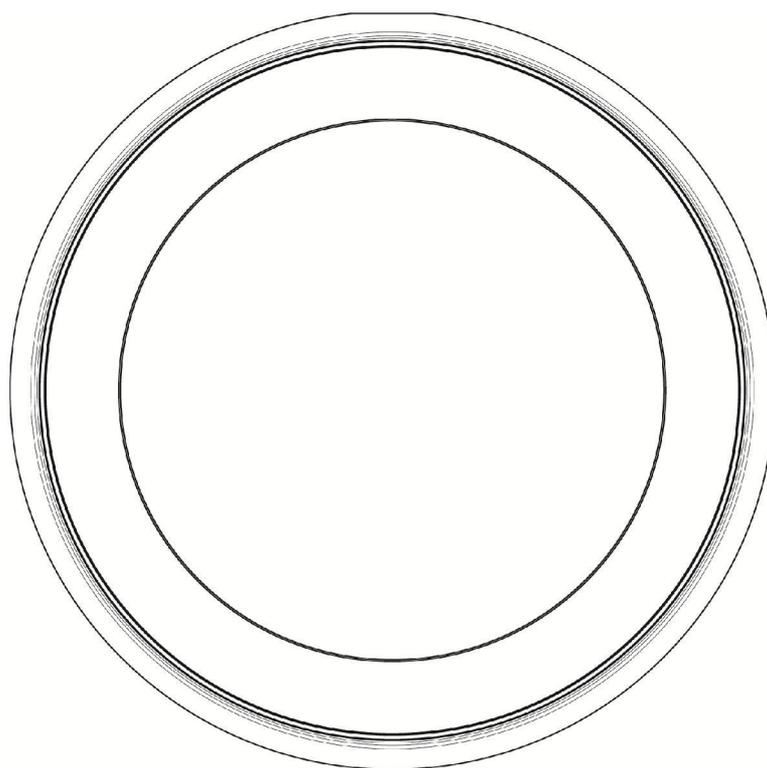
【左側視圖】



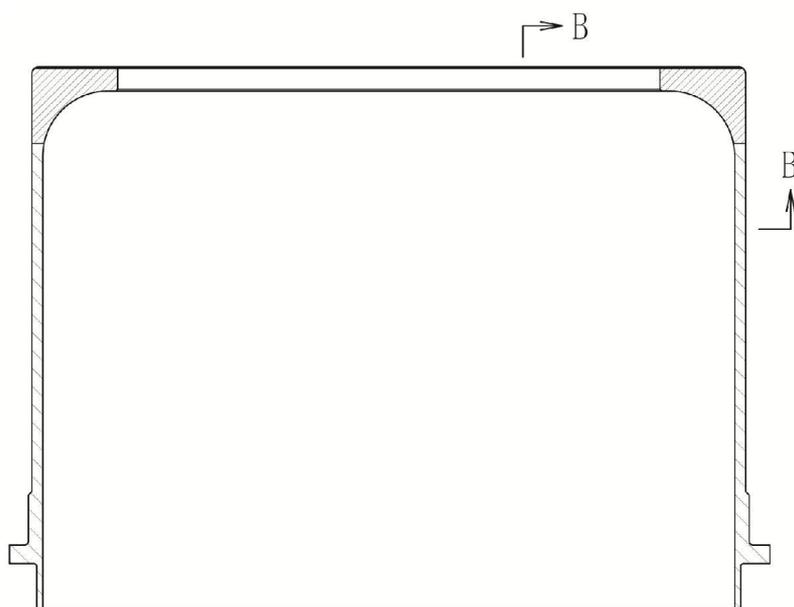
【右側視圖】



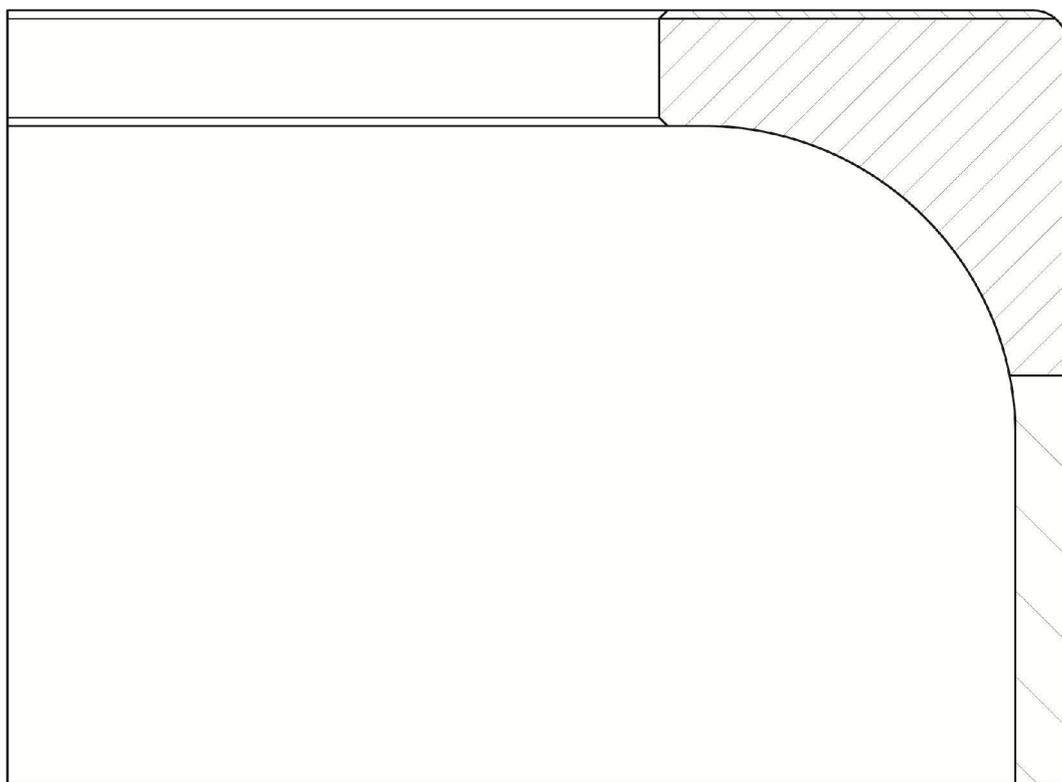
【俯視圖】



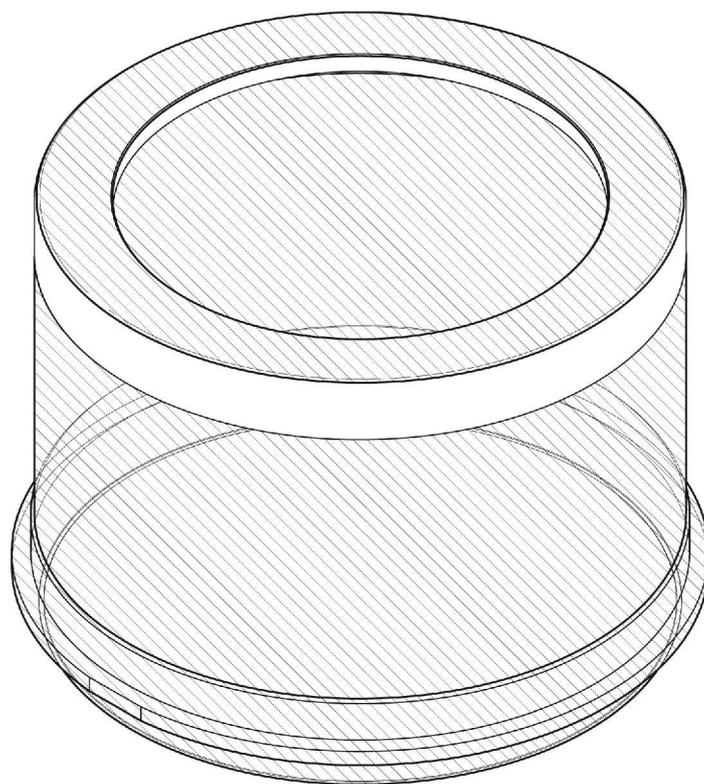
【仰視圖】



【A-A剖面圖】



【B-B剖面圖】



【表示透明部分參考圖】